

業界最速

C02レーザーによる高速加工

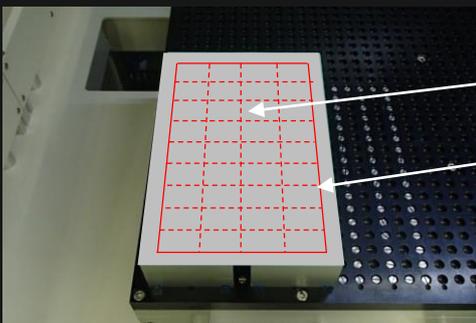
セラミックス製品の量産において
求められる **高い処理能力**と
高精度・高品質な加工を両立



セラミックス

スクライブ、フルカット
微細穴あけ

ガルバノスキャナと加工テーブルの同期制御



焼成後セラミックス

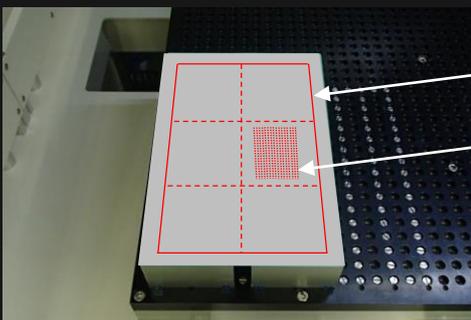
スクライブ (点線部分)

フルカット (実線部分)



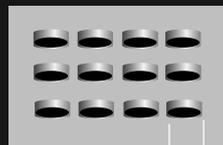
スクライブ断面イメージ

光学技術とガルバノスキャナの高速微細穴あけ



グリーンシート

スクライブ・フルカット
微細穴あけ (TLSM-401)



表面イメージ

穴直径 $\sim \phi 50\mu\text{m}$

Sharpen section and No heat effect surface.
<http://www.takei-ele.co.jp>